

# 《现代电子产品组装工艺》

## 图书基本信息

书名：《现代电子产品组装工艺》

出版时间：2012-1

页数：290

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《现代电子产品组装工艺》

## 内容概要

《现代电子产品组装工艺》是教育部和财政部“中等职业学校教师素质提高计划”中“电子技术应用专业师资培训包开发项目(LBZD036)”的成果之一。《现代电子产品组装工艺》分为7个相对独立的单元：电子企业模拟参观，电子企业安全用电、静电防护与5S，电子元器件识别与进货检验，通孔PCB组件组装，表面贴装印制电路板的手工组装与返修，手工组装SD-202T型收音机，表面贴装印制电路板组装。这7个实训单元是中等职业技术学校《电子技术应用专业教师教学能力标准(试行)》中要求的重要内容，也是现代电子产品生产、组装的核心知识和技能。培训项目紧密结合现代电子制造企业的PCB组装、SMT、测试、物料采购与准备、品质检验与管理等岗位的工作任务。项目按照由简单到复杂，从相对单一到综合应用的逻辑关系组织和递进。书中安排了技能训练和综合应用两个层面的项目。技能训练项目参照国际通行的行业标准IPC-610C设计，以奠定完成综合项目必需的技能。综合项目以完成有实用价值的典型电子产品(通孔、表面混装的收音机、计算机主板)为目标成果，按照理论实践一体、行动导向和工作过程引领的教学理念编写，以培训学员的综合职业能力。技能训练项目和综合项目既符合职业成长规律，又便于国家职教基地用于上岗、提高、骨干三个层级的教师培训时灵活选用。《现代电子产品组装工艺》的编写是为满足中等职业学校电子技术应用专业教师国家级培训的急需，也试图为电子类专业工艺课程教学及实训提供可供参考的解决方案。《现代电子产品组装工艺》可作为中等职业学校电子类专业的教材和电子企业的员工培训教材。

# 《现代电子产品组装工艺》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)